

2009年(平成21年)春季 第56回応用物理学関係連合講演会シンポジウムのご案内

「産業化に向かう集積化MEMS技術の先端開発動向」

主催 応用物理学会
集積化MEMS技術研究会
委員長 石田 誠(豊橋技科大学)

平成20年5月、応用物理学会に集積化MEMS技術研究会が設立いたしました。これまでに2回の研究会を開催し、多くの方の参加と活発な議論があり、本研究会への期待の大きさを感じました。2009年(平成21年)春季講演会が2009年3月30日(月)～4月2日(木)の期間筑波大学(茨城県つくば市天王台1-1-1)において開催されます。この度、本研究会主催により31日(火)(10:00～17:30)に下記主旨のもとシンポジウムを開催いたします。是非皆様のご参加をお願い申し上げます。

[主旨]

近年、CMOS技術やMEMS技術単独では実現できない新機能と付加価値を有する「集積化MEMSデバイス」が次々と市場に出現しています。MEMSとCMOS-LSIとを融合する集積化MEMS技術は、世界的潮流であるMore than Mooreの一つの解であり、産業への貢献が期待されています。集積化MEMS技術が産業化に貢献するためには、回路設計技術、プロセス技術、実装技術、テスト技術、高信頼化技術などの要素技術において産業化のための新たな課題を克服する必要があると考えます。同時に、これら要素技術が分散することなく本技術分野全体を統合的、戦略的かつ学術的に推進することも必要であると考えます。

このような背景において、産業化に向けて、集積化MEMS技術を活発に研究開発している各専門家とLSI関係者が一同に会する機会を応用物理学会の場に設けることで、本分野の先端技術動向、課題と展望についての有益な意見交換と技術討論を期待したいと思います。

上記主旨のもと、シンポジウムのプログラムとしてMEMS技術のこれまでの実情と将来、回路設計の課題、海外の動向、ファウンドリビジネスの課題、信頼性とテスト技術の実態、封止やスクライブなど実装技術の実情などの観点から、現在、ご活躍されている先生方にお願ひし、シンポジウムを構成いたしました。また、講演後総合討論を行うこととし、活発な議論を期待したいと考えております。

[プログラム]

1) イントロダクトリートーク:集積化MEMS技術	10:00 -10:15	石田 誠 (豊橋技科大)
2) 集積化MEMSのこれまでとこれから	10:15 -11:00	田中 秀治(東北大)
3) MEMS等価回路モデルを用いた設計プラットフォーム	11:00 -11:30	橋口 原 (静岡大)
4) IMEC's Strategy and Activity on MEMS	11:30 -12:00	Philip Pieters (IMEC)
昼食(インフォーマルミーティング:委員会)	12:00 -13:15	
6) MEMSファウンドリから見た集積化MEMS技術	13:15 -13:45	武居正彦(富士電機)
6) LSIファウンドリを用いたCMOS/MEMS	13:45 -14:15	Chiung-I Lee(台湾工業技術研究院)
7) MEMS・センサと集積回路の統合化技術	14:15 -14:45	高尾英邦(豊橋技科大)
8)高信頼性化のためのスティッキング防止技術	14:45 -15:15	阪田 知巳(NTT)
休憩(15分)	15:15 -15:30	
9) MEMSデバイスのためのテスト技術	15:30 -16:00	渡辺 彰一(東京エレクトロン)
10)MEMS技術のための封止装置技術	16:00 -16:30	足立 秀喜(大日本スクリーン)
11)MEMS実装技術のためのステルスダイシング	16:30 -17:00	内山 直己(浜松ホトニクス)
12)総合討論	17:00 -17:30	年吉 洋 (東京大)

世話人： 高尾英邦(豊橋技科大) 田中秀治(東北大学) 年吉 洋(東京大学) 秦 誠一(東工大)

本件問合せ先：(社)応用物理学会 苅米義弘 TEL 03-3238-1044 karigome@jsap.or.jp
集積化MEMS技術研究会 副委員長 益 一哉(東工大)
TEL 045-924-5022 e-mail:masu@ieee.org